

日本セラミックス協会関西支部 平成30年度支部セミナー 開催案内

【主催】 日本セラミックス協会関西支部

【共催】 大阪大学大学院工学研究科

【協賛】 日本化学会、電気化学会、高分子学会、応用物理学会、粉体粉末冶金協会、日本希土類学会

【日時】 2018年12月3日（月） 10:00～16:45

【会場】 大阪大学 銀杏会館 阪急電鉄・三和銀行ホール

（吹田キャンパス：大阪モノレール「阪大病院前」徒歩5分）
(http://caren.eng.osaka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/access_to_ichokaikan.pdf)

【定員】 約80名

【テーマ】 組成・構造制御によるセラミックス材料の革新的物性発現

【プログラム】 (10:00～16:45)

10:00～10:05 開会挨拶

10:05～11:05 藤田 晃司 先生（京都大学）

「層状ペロブスカイトエンジニアリング：新規強誘電体・圧電体の開拓」

11:05～12:05 島ノ江 憲剛 先生（九州大学）

「酸化物半導体ガスセンサの材料設計 ～どこまで性能を引き出せるか」

（昼食休憩）

13:30～14:30 野口 仁 先生（富士フィルム株式会社）

「ビッグデータ・IoT時代を支えるバリウムフェライト磁性体を用いた大容量磁気テープの開発」

14:30～15:30 吉田 朋子 先生（大阪市立大学）

「半導体光触媒可視光応答化を制御する添加窒素化学状態」

（休憩）

15:40～16:40 辰巳砂 昌弘 先生（大阪府立大学）

「ガラス系イオニクス材料を用いた全固体リチウム電池の開発」

16:40～16:45 閉会挨拶

【参加費】 参加費・懇親会費の支払いは当日会場にて受け付けます。

- セラミックス協会・協賛学協会会員（一般）：6,000円
- セラミックス協会・協賛学協会会員（学生・シニア・永年継続会員）：2,000円
- 支部賛助会員企業：1名無料 / 2人目からは6,000円（ただし、特級は2名無料）
- 非会員：11,000円（講演予稿集代含む）

【懇親会】 (17:00～19:00) 銀杏クラブ（銀杏会館内） 会費 一般7,000円、学生5,000円

【参加申込方法】 ホームページ内の参加申込フォームに必要事項を記載の上、世話役（大阪大学 田村）までE-mail添付にて送付

【申込・問合先】

大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 田村真治

TEL: 06-6879-7353, E-mail: shinji@chem.eng.osaka-u.ac.jp

【申込締切】 2018年11月26日（月） <定員になり次第締切>